

株主懇談会

2013年 6月21日

株式会社 リョーサン

本日のご報告内容

1. 新役員体制のご紹介
2. 2013年度 経営の取り組み
3. 2013年度 業績計画

1. 新役員体制のご紹介

新 役 員 体 制

代表取締役	社長 兼 企画本部長	三松 直人	取締役	国内第一営業本部長 兼 半導体第二事業本部長	佐藤 和典
常務取締役	営業管理本部長 兼 国内第三営業本部長 兼 半導体第一事業本部長	栗原 宏幸	取締役	財務本部長 兼 管理担当	佐野 秀一
取締役	国内第二営業本部長	渋谷 裕	取締役	電子機器事業本部長	吉泉 康雄
取締役	技術本部長	坂田 敏文	取締役 (社外)		小松 正明
取締役	電子部品事業本部長	小山 強	監査役 (常勤)		関 晴光
取締役	生産事業本部長	高林 聡	監査役 (常勤)		本田 健
取締役	海外営業本部長	本間 宏二	監査役 (社外)		中野 廣太郎
			監査役 (社外)		藤野 利行

2. 2013年度 経営の取り組み

現状の認識

外部環境

- ◇世界的な経済・産業構造の変化
- ◇半導体業界内での構造変化
 - ・半導体メーカーの新たな再編
 - ・半導体商社の優勝劣敗が鮮明に

当社の課題

- ◇売上高の伸び悩み
- ◇利益率(売上総利益、営業利益)の低迷

【基本的な姿勢】

「持続的成長」と「健全経営」を目指す

【具体的な取り組み】

第2、第3の柱となる事業の育成

技術商社としての取り組み強化

各事業セグメントの取り組み強化

企業体質の更なる改善

第2、第3の柱となる事業の育成

◇海外半導体デバイス事業等の更なる強化

・新規リソース開発プロジェクトの推進

目的：当社の持続的成長を果たすための新規リソースの発掘

目標：・当社グループ全体に展開できる新規リソースで早期に業績貢献する
・新規リソースによって当社の事業拡大が可能かどうか判断する

・海外半導体デバイス事業の更なる強化

目的：海外半導体デバイスビジネスを成長戦略として、再チャレンジする

目標：海外半導体をメインで取り扱う各子会社(サクシス、ジャイロニクス)で
数百億円規模の売上高を目指す

※「第8次中期経営計画 成長戦略」に上記戦略を追加する

第8次中期経営計画 成長戦略の追加修正

1. 海外半導体デバイス事業等の更なる強化

追加

2. 急成長する新興国市場(中国・インド)への取り組み強化

3. グローバル化する日系顧客への対応強化

4. 成長分野(カーエレクトロニクス・社会インフラ等)の開拓強化

技術商社としての取り組み強化

◇中期的なテーマ

- ・得意分野の拡大とシステム技術力の深耕
- ・成長市場に向けた技術の拡充とグローバル展開

◇13年度の取り組み

～売り切る技術の強化～

- ◇システム技術力(要素技術含む)と提案力の強化
- ◇受託開発(ASIC・ソフト開発)を通じた開発力の強化
- ◇サプライヤを補完する技術サポート力
(デバイス応用技術力)の強化
- ◇成長市場への保有技術のグローバル展開
韓国、中華圏、インド市場でのデザイン・イン推進

半導体事業の取り組み強化

◇中期的なテーマ

【国内サプライヤー】

主力サプライヤーの事業構造変化への対応力を高め、収益体質の再構築と事業成長を果たす

【海外サプライヤー】

海外サプライヤーの期待に応える機能強化により事業拡大を果たす

◇13年度の取り組み

【国内サプライヤー】

- ・成長分野である車載・電装分野の集中攻略
- ・新市場の開拓と攻略（スマートグリッド、LED照明等）
- ・現地デザインハウスとの協業による海外ローカル顧客への拡販（中国、韓国）

【海外サプライヤー】

サクシス社、ジャイロニクス社の人員を増強し、販売体制の強化

電子部品事業の取り組み強化

◇中期的なテーマ

品揃えの拡充と海外市場の展開

◇13年度の取り組み

- ・品揃えの拡充

LED、光学式入力デバイス、センサ等の拡販

- ・海外市場の展開強化

中国電子部品専売部を新設し、ローカルビジネス事業の拡大

- ・成長分野の開拓強化

車載電装、社会インフラ、情報通信、デジタルコンシューマ機器

電子機器事業の取り組み強化

◇中期的なテーマ

新規ビジネスモデルへの取り組みと成長分野の攻略による事業規模の拡大実現

◇13年度の取り組み

- ・新規ビジネスモデルの取り組み
受託加工サービス、素材 [磁気シート等]販売等
- ・品揃えの拡充
台湾・中国サプライヤー、中堅設備機器ベンチャー等で新ビジネスを開拓
- ・成長分野の市場・顧客開拓
環境エネルギー、社会インフラ、次世代半導体
- ・グローバル対応
中国等でのプラットフォームビジネス、台湾企業への素材販売等

生産事業の取り組み強化

◇中期的なテーマ

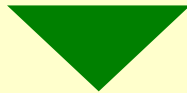
事業拡大と収益力強化の実現

◇13年度の取り組み

- ・戦略的な市場攻略で効率的な事業拡大
重電・産業・FA、環境・エネルギー、車載、医療等の戦略市場に特化し、リソースを集中して高付加価値事業を拡大
- ・新製品、新技術の投入による事業拡大
液冷、ウェーブクーラー機能の向上、産業用途新製品の立ち上げ等
- ・一貫管理の徹底
体制、管理方法を改め、一貫性を強化し、責任の明確化とスピードアップ
- ・生産体制の再構築
5年先を見越した事業体制、最適生産MAPを構築

◇収益体質の改善

- ・主力サプライヤーの事業構造改革や、日本のエレクトロニクス産業の低迷により、収益体質が悪化



- ・利益率改善に向けて間断なきチャレンジ
 - ↳ 技術サポートなど付加価値を付けた営業活動の実践により適正な売上総利益率を確保する

◇財務体質の改善

- ・棚卸資産回転月数の適正化：目標1ヶ月未満
 - ↳ キメの細かい納期管理を徹底する事で無駄な在庫を削減する

◇全グループ子会社の連結子会社化に向けた インフラの整備と小さな政府の維持

・主な連結子会社化する会社名称及び事業内容

名 称	事 業 内 容
株式会社イーシーリョーサン	電子部品のコミッションセールス
RYOSAN TECHNOLOGIES USA INC.	半導体・電子部品の販売
DALIAN F.T.Z RYOSAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.	半導体・電子部品の販売
SHEN LING ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.	半導体・電子部品のコミッションセールス
RYOSAN EUROPE GMBH	半導体・電子部品の販売
RYOSAN ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD.	ヒートシンクの製造・販売

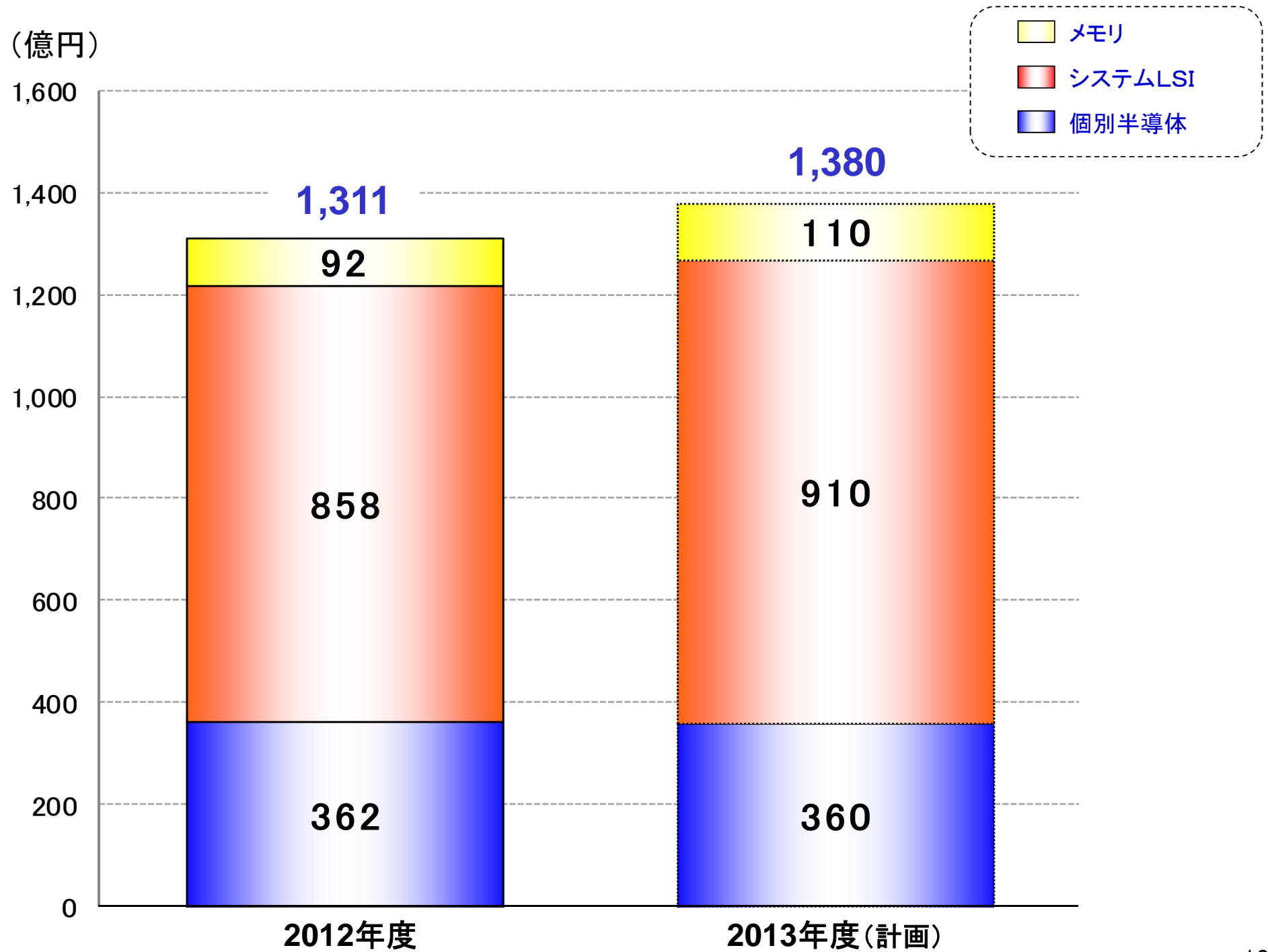
3. 2013年度 業績計画

連結業績の計画

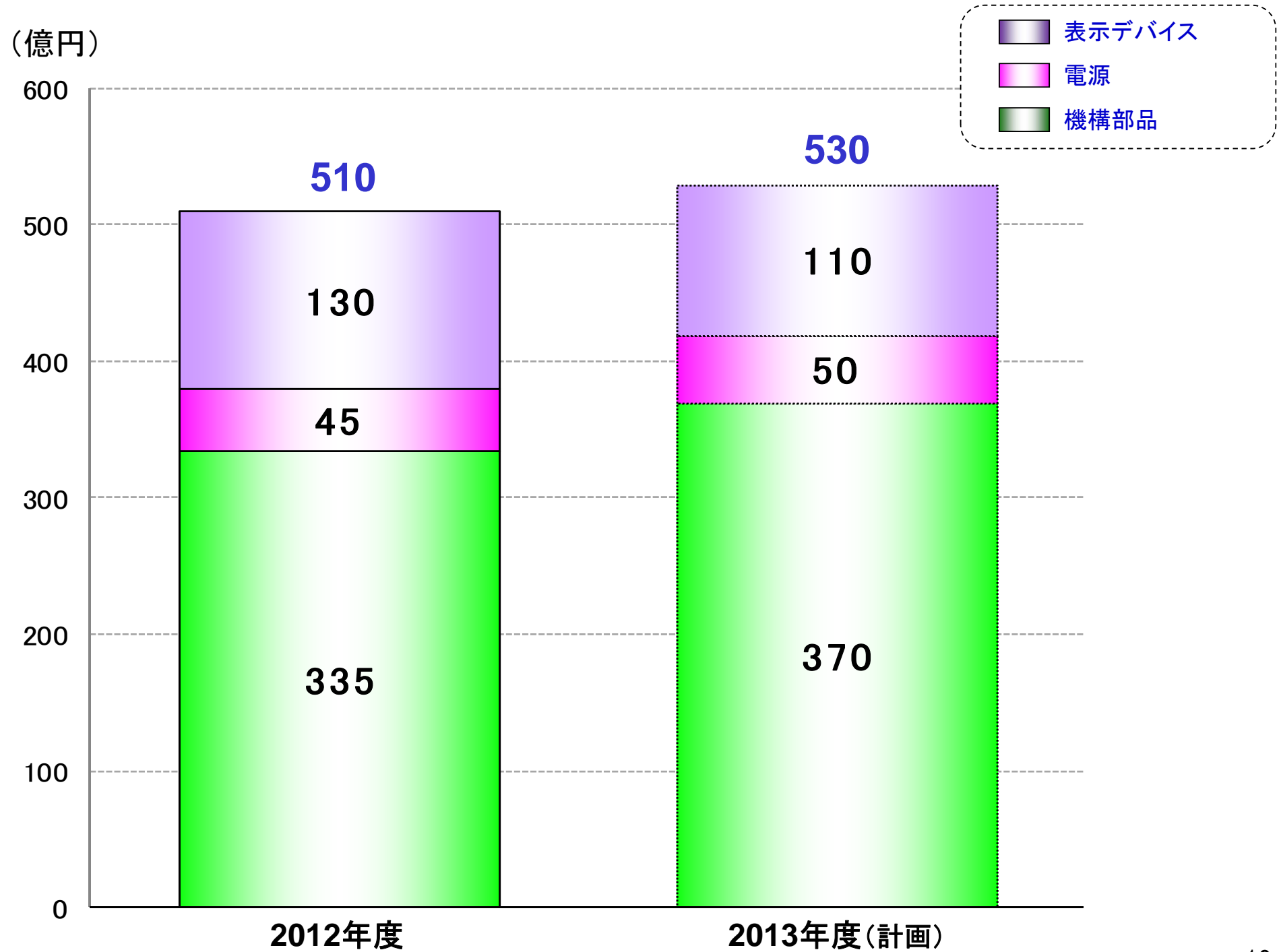
単位:億円

	2012年度			2013年度(計画)		
		売上高比	前年比		売上高比	前年比
売上高	2,065	%	△5.2%	2,150	%	+4.1%
売上総利益	166	8.1	△0.6%	176	8.2	+5.6%
販管費	129	6.3	△2.0%	130	6.0	+0.1%
営業利益	36	1.8	+4.6%	46	2.1	+25.2%
経常利益	41	2.0	△8.1%	48	2.2	+16.7%
当期純利益	28	1.4	+48.2%	30	1.4	+6.6%
1株当たり当期純利益	84円40銭			92円41銭		

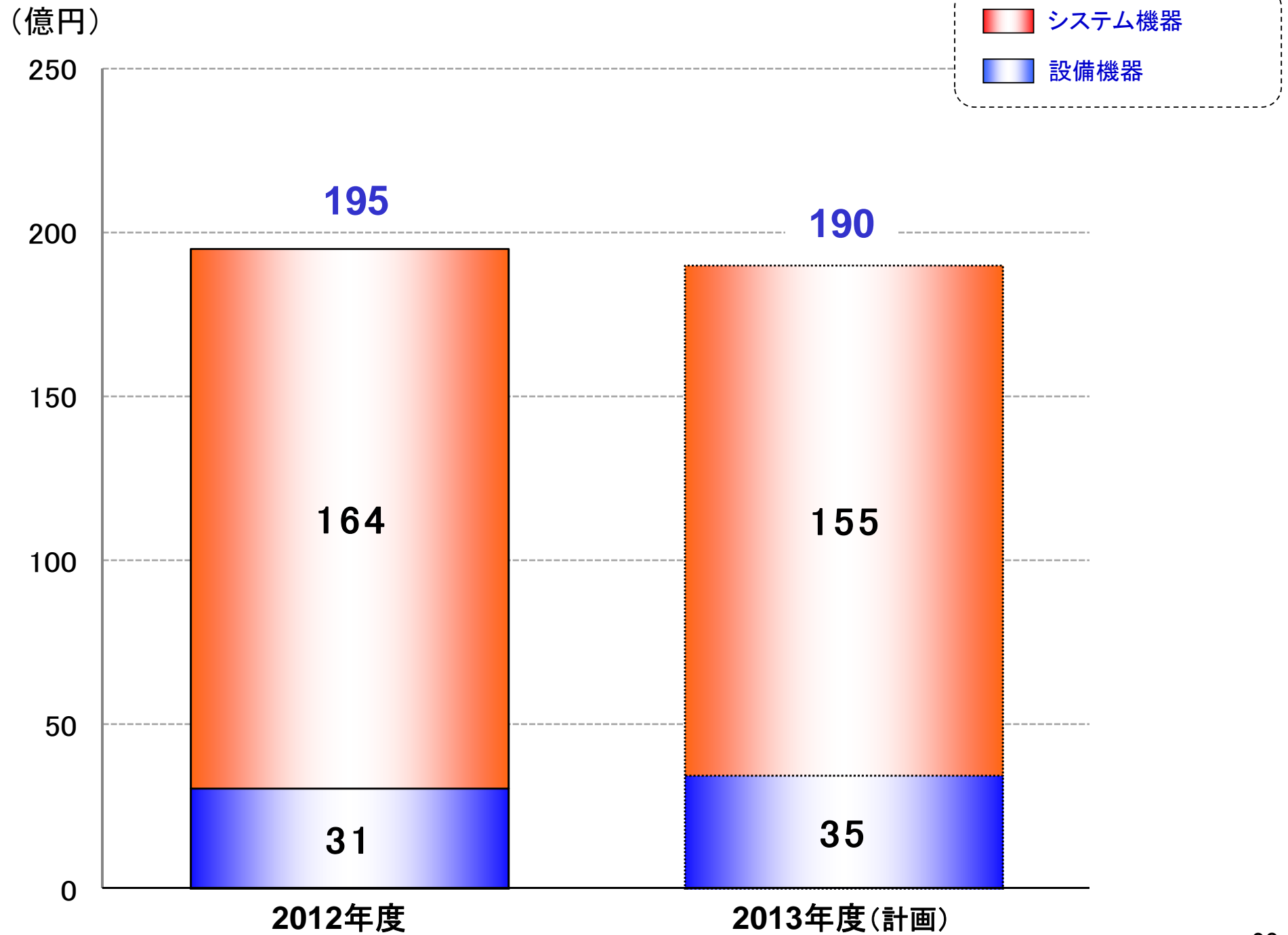
半導体事業の売上高計画



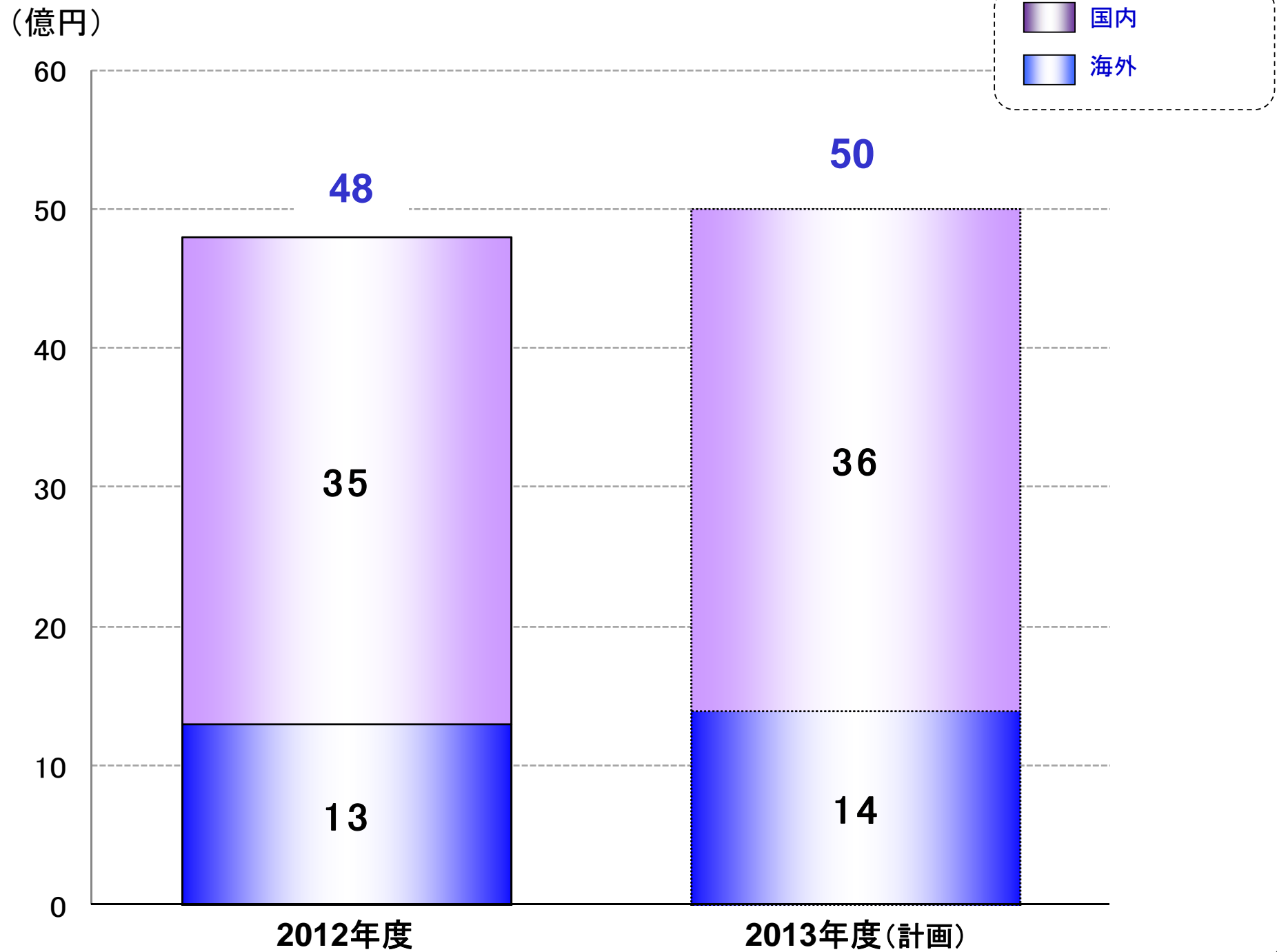
電子部品事業の売上高計画



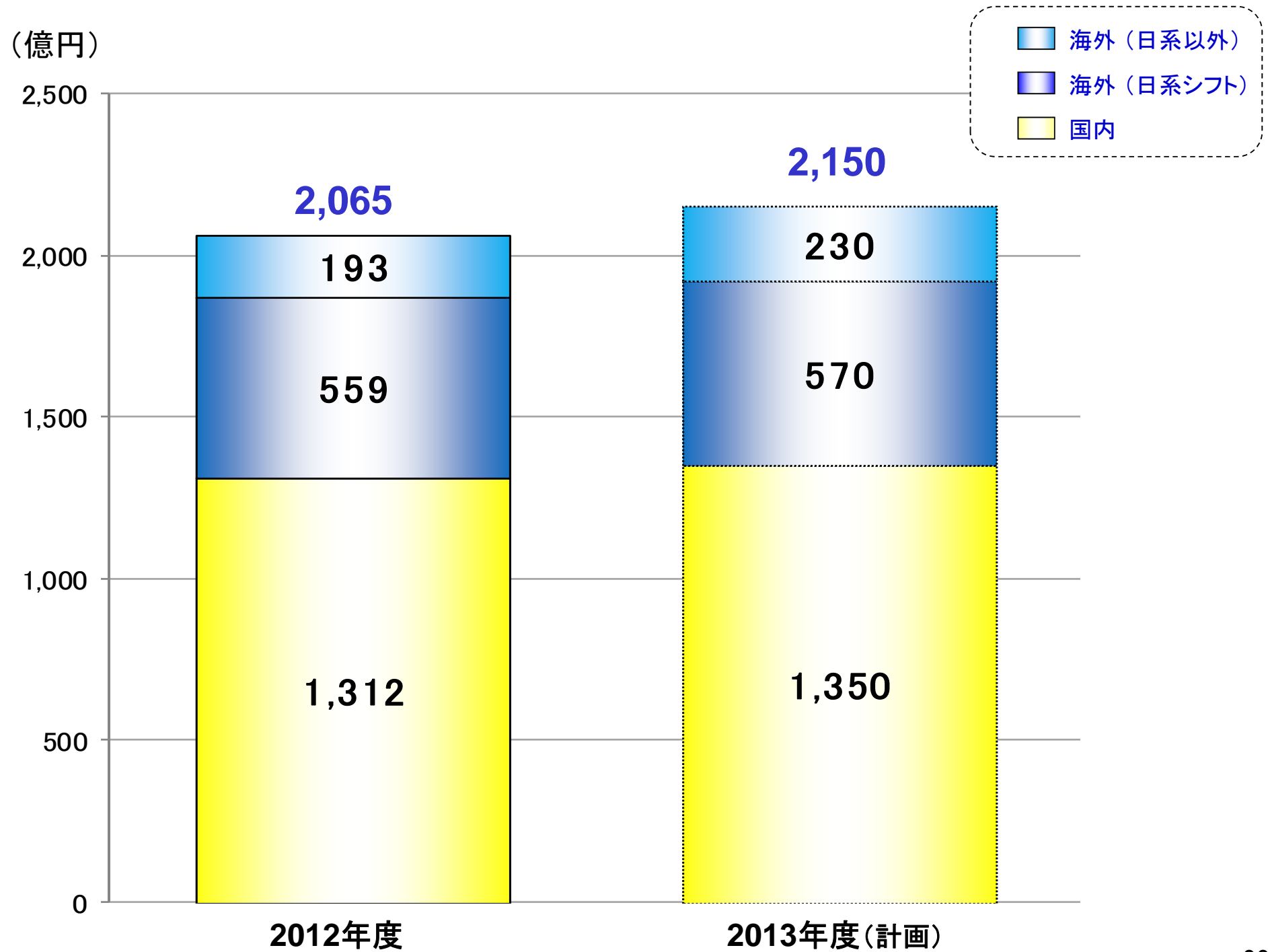
電子機器事業の売上高計画



生産事業の売上高計画



国内・海外の売上高計画



1. 基本方針

- 安定的に高配当を維持

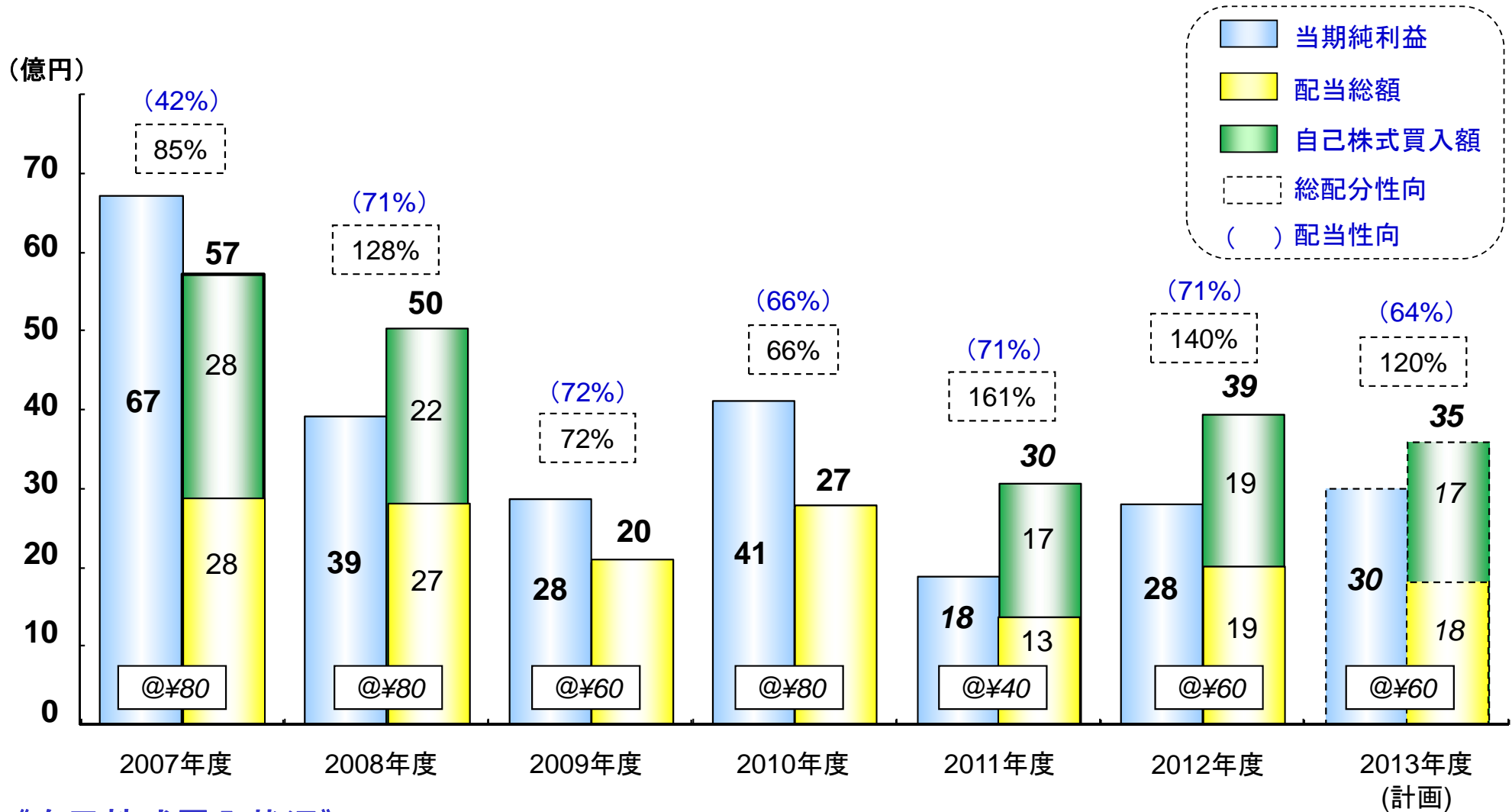
2. 基本経営指標の設定

- (1) 毎年：連結配当性向50%以上
- (2) 2013年度目標：株主資本配当率(DOE)2.5%以上

3. 自社株買いについて

- 2011～2013年度において各100万株の買入れを実施

当期純利益と配当総額・自己株式買入額の推移



《自己株式買入状況》

	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度
金額 (億円)	28.8	22.5	—	—	17.2	19.8	17.9
株数 (万株)	100.0	100.0	—	—	100.0	100.0	100.0